

PRESSEMITTEILUNG

Veröffentlichung vom Dezember 2019

BGM210P

Bluetooth 5 mit einer Reichweite von bis zu 1,8km

HY-LINE Communication Products GmbH präsentiert das Bluetooth PCB Modul BGM210P von Silicon Labs. Es basiert auf dem Wireless Gecko Serie 2 SoC, bietet eine beispiellose HF-Reichweite von 1,8 km und bis zu 20 dBm Leistung, in Kombination mit einer leistungsstarken MCU, 1MB Flash-Speicher, OTA Firmware und Core für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen. Darüber hinaus punktet das BGM210P mit einem Temperaturbereich weit über dem Industriestandard.

Features

- Bluetooth 5.1 & Bluetooth Mesh
- Betriebstemperatur -40 °C bis +125 °C
- Linkbudget bis zu 117 dB
- ARM Cortex -M33 MCU

Bild: PM_BGM210P.jpg

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

<https://www.hy-line.de/silabs/BGM210P>

erstellt für:

HY-LINE Communication Products

Carsten Pfaff

Inselkammerstr. 10; D-82008 Unterhaching

Tel.:089/614503-236 ; Fax: 089/6140960

E-Mail: c-pfaff@hy-line.de ; Web: www.hy-line.de/communication

hy-line.de

LEADER IN TECHNOLOGY.

erstellt von:

Oliver Gropp, HY-LINE Holding,

Tel. 089/614503-48

Email: o-gropp@hy-line.de